RAPPORT TECHNIQUE

TECHNICAL REPORT

CEI
IEC
60828

Première édition
First edition
1988-05

Allocation des broches de connecteurs pour les systèmes à microprocesseurs utilisant le connecteur IEC 603-2

Pin allocations for microprocessor systems using the IEC 603-2 connector

© IEC 1988 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site http: //www.iec.ch

Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE D

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ALLOCATION DES BROCHES DE CONNECTEURS POUR LES SYSTEMES A MICROPROCESSEURS UTILISANT LE CONNECTEUR IEC 603-2

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PREFACE

Le présent rapport a été établi par le Sous-Comité 47B de la CEI: Sytèmes à microprocesseurs, du Comité d'Etudes n° 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Le texte de ce rapport est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
47B(BC)23	47B(BC)29

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de ce rapport.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PIN ALLOCATIONS FOR MICROPROCESSOR SYSTEMS USING THE IEC 603-2 CONNECTOR

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendation for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This report has been prepared by Sub-Committee 47B: Microprocessor systems, of IEC Technical Committee No. 47: Semiconductor devices.

The text of this report is based on the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
47B(CO)23	47B(CO)29

Full information on the voting for the approval of this report can be found in the Voting Report indicated in the above table.

ALLOCATION DES BROCHES DE CONNECTEURS POUR LES SYSTEMES A MICROPROCESSEURS UTILISANT LE CONNECTEUR IEC 603-2

1 Domaine d'application

Le présent rapport décrit le nombre minimal de broches de masse électrique devant être affectées à chaque connecteur IEC 603-2* utilisé dans les systèmes à base de microprocesseurs.

Ce rapport fournit également des recommandations et décrit les restrictions à apporter pour l'affectation des liaisons d'alimentation et de masse lors de l'utilisation du connecteur IEC 603-2 dans les systèmes à base de microprocesseurs.

Ce rapport s'applique à la fois aux connecteurs placés sur les cartes et à ceux placés sur le fond de panier des systèmes à microprocesseurs.

Note.- Les termes "broche" et "terminaison" sont considérés comme synonymes.

---

* Se reporter à la Publication 603-2 de la CEI: Connecteurs pour fréquences inférieures à 3 MHz pour utilisation avec cartes imprimées, Deuxième partie: Connecteurs pour circuits imprimés en deux parties, pour grille de base de 2,54 mm (0,1 in) avec caractéristiques de montage communes.

PIN ALLOCATIONS FOR MICROPROCESSOR SYSTEMS USING THE IEC 603-2 CONNECTOR

1 Scope

This report describes the minimum number of d.c. ground terminals to be allocated to each IEC 603-2* connector used in microprocessor-based systems.

This report also makes recommendations and describes restrictions for the allocation of power and ground connections when using the IEC 603-2 connector in microprocessor-based systems.

This report applies to both the boards and backplane connections in microprocessor systems.

Note.- The words "pin" and "terminal" are used interchangeably.

* Refer to IEC Publication 603-2: Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards, Part 2: Two-part connectors for printed boards, for basic grid of 2.54 mm (0.1 in) with common mounting features.